

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

環德為國內首家專注於高頻整合元件與模組的設計及製造公司，運用先進的陶瓷及電路設計技術與模組封裝技術，提供無線通訊產品高附加價值的整體解決方案。民國一一年通訊產業歷經局勢紛擾的一年，受到總體經濟不穩定的影響，導致終端消費市場需求放緩。回顧全年的表現，環德營業收入淨額為新台幣1,465,282千元，稅後淨利為新台幣275,353千元，每股稅後盈餘為3.99元，在經營團隊與全體同仁共同努力之下，使整體經營成果能維持穩定的獲利。

回顧過去一年，我們生活的各個層面幾乎都已受到疫情帶來的影響，儘管在全球面臨疫情衝擊環境下，環德仍堅持產品創新與技術持續提昇，隨著傳輸量及傳輸速率仍不斷地快速提昇需求下，環德仍持續在寬頻與高頻應用切入物聯網、穿戴裝置、汽車與毫米波相關應用，配合客戶需求順利開發各項多頻多模整合元件。另因應全球手機的持續升級，環德亦能提供智慧型手機所需的解決方案。此外，環德也持續積極開發多款WiFi、窄頻物聯網(NB-IoT)、手機相關之射頻前端(FEM)模組及系統級封裝(SiP)模組，且也積極進行高功率基站元件的開發，並對於5G毫米波基站所須高階LTCC天線模組、濾波元件的基板材料與設計技術研發也多有進展，使產品組合更加完整並且大幅提高產品技術層次，期望能進一步推升環德長期的競爭優勢。

全球第五代行動通訊技術(5G)熱度仍持續升高，第六代行動通訊技術(6G)也蓄勢待發，預期將帶來顯著的經濟效益，未來車聯網、物聯網、自動駕駛、智慧工廠、智慧城市與低軌道衛星等無所不在的通訊需求，也將大幅驅動5G與6G的發展。環德現已投注資源於5G第一階段(Sub-6GHz)與WiFi6E的零組件開發，對於未來毫米波應用，及相應5G的WiFi7應用的相關技術也廣泛布局。環德擁有先進RF電路設計、材料開發、製程設計及產品測試等四大核心技術，可因應通訊市場的未來發展所需，提供客戶多樣化，小型化，模組化的產品服務，並配合新技術的需求開發出新應用的產品。

展望未來，隨著無線通訊技術不斷精進，無線產品的應用將愈加多元與普及，而傳輸速率規格的快速提升，再加上終端產品小型化及元件積體化的趨勢等等，市場對高頻整合元件與模組的需求也將日益增加。環德將會持續專注於無線通訊領域，投入新技術解決方案，透過加速技術創新及產品升級，提供客戶高附加價值的整合型服務。期望在團隊共同努力下，以先進的研發技術與生產實力為基礎，積極開發海內外客戶並強化策略合作關係，全力擴展公司的經營規模與市場占有率，再創營運佳績。

環德秉持穩健務實的經營理念，全體同仁將會全力以赴提升公司的整體價值。最後，再次感謝各位股東長期的支持與愛護，謝謝大家！

環德電子工業股份有限公司

董事長：雙德投資股份有限公司  
代表人 郭建文

